

C11000



► 物理性能*

密度	8.91	g/cm ³
熔点	1083	°C
导电率**	≥97.4	%IACS
热导率	391.4	W/(m·K)
热膨胀系数***	16.97	10 ⁻⁶ /K
弹性模量	117.2	GPa

► 牌号

中国GB	T11050/T2
美国UNS	C11000
欧洲EN	CW004A/Cu-ETP
日本JIS	C1100

► 化学成分

铜+银Cu+Ag	≥99.9	%
铅Pb	≤0.005	%
铋Bi	≤0.001	%
锑Sb	≤0.002	%
铁Fe	≤0.005	%
砷As	≤0.002	%
硫S	≤0.005	%

► 加工性能

冷加工	极好
热加工	极好
钎焊	极好
电阻焊	不推荐
车削性能*	20%

► 力学性能*

状态	规格 mm	抗拉强度	屈服强度	延伸率	硬度	硬度
		MPa min.	MPa	A% min.	HRB	HBW
H04	3.0≤Φ≤10	300	200	5.0	20-55	/
	10<Φ≤60	260	168	6.0	20-55	/
H02	3.0≤Φ≤10	300	/	9.0	30-50	/
	10<Φ≤45	228	217	10	/	80~95
O60	3.0≤Φ≤80	200	100	40	30-50	/

合金具有优良的导热、耐蚀性和优良的加工性，易于承受拉伸、墩铆、挤压、缠绕、深冲、热锻等加工。一般条件下无“氢脆性”，可以在还原性气氛条件下加工和使用，但不宜在高温氧化条件下加工和使用。

主要应用于电器行业，例如导电帽、汽车导电配件等；